

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
24. Februar 2022 (24.02.2022)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2022/037890 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

H01L 21/683 (2006.01) H01L 21/687 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2021/070436

(22) Internationales Anmeldedatum:

21. Juli 2021 (21.07.2021)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

20191459.5 18. August 2020 (18.08.2020) EP

(71) Anmelder: **SILTRONIC AG** [DE/DE]; Einsteinstr. 172
Tower B / Blue Tower, 81677 München (DE).

(72) Erfinder: **GEISLER, Sebastian**; August-Bebel-Straße
43, 09618 Brand-Erbisdorf (DE). **LAMPRECHT, Lud-
wig**; Osterbergstraße 6a, 83376 Truchtlaching (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM,
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA,
MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,

NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,
RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT,
LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI,
SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,
GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A VACUUM GRIPPER FOR SEMICONDUCTOR WORKPIECES, AND VACUUM GRIPPER

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES VAKUUMGREIFERS FÜR HALBLEITERWERKSTÜCKE UND VAKUUMGREIFER

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a vacuum gripper (100) for semiconductor workpieces, in which the vacuum gripper (100) is produced from at least one base material by means of an additive construction method, and to a vacuum gripper (100) of this type.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines Vakuumbreifers (100) für Halbleiterwerkstücke, bei dem der Vakuumbreifer (100) aus zumindest einem Grundmaterial mittels eines additiven Aufbauverfahrens erzeugt wird, sowie einen solchen Vakuumbreifer (100).

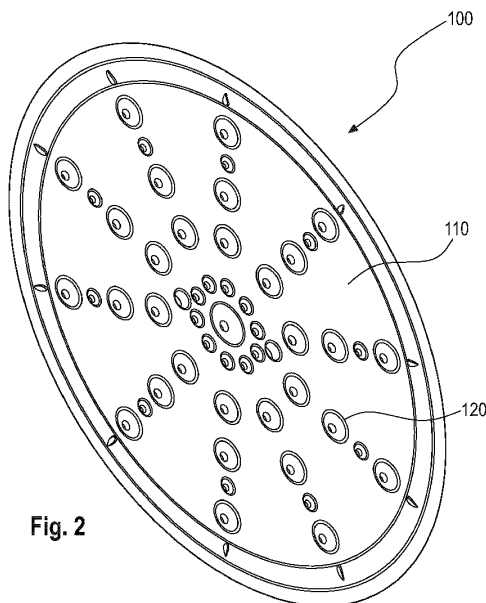


Fig. 2



WO 2022/037890 A1